

平成26年度アクションプラン特定施策 (パワーエレクトロニクス領域)のコメント

三菱電機株式会社

大森 達夫

2014年1月16日

コメント

- (1) パワーエレクトロニクスは、基礎研究や材料物性、部材、ウエハ、パワーチップ、受動部品、パッケージ・実装（パワーモジュール）、回路・制御、機器（アプリケーション）、システムの各階層から構成され、広い技術分野にまたがっている。このために各階層での部分最適に陥ることなく、上位階層の出口での全体最適を間は得る。あわせて製品化（事業）出口を考えたターゲット（システム、機器、パワーモジュールやウエハ、部材）目標を明確にし、その重要度に応じた施策や取組を考える必要がある。
- (2) 各府省の施策内容については、全体を俯瞰した図（全体像の見える化）をつくり、世の中に広く展開するのに重要な施策が過不足なく、かつ連携しつつ体系的に計画されていて、目標・マイルストーン・予算・実施形態が十分かの検証を行って、より良い計画にすべきである。
- (3) パワーエレクトロニクスの主な応用分野は、①モータコントロールと②電源制御であり、この両分野での次世代技術の高性能化技術に加え、さらなる高付加価値化技術、実用化技術、低コスト化技術を開発、実現して適用機器やアプリケーション分野の拡大、普及を進める。

パワーエレクトロニクスを支える技術領域



